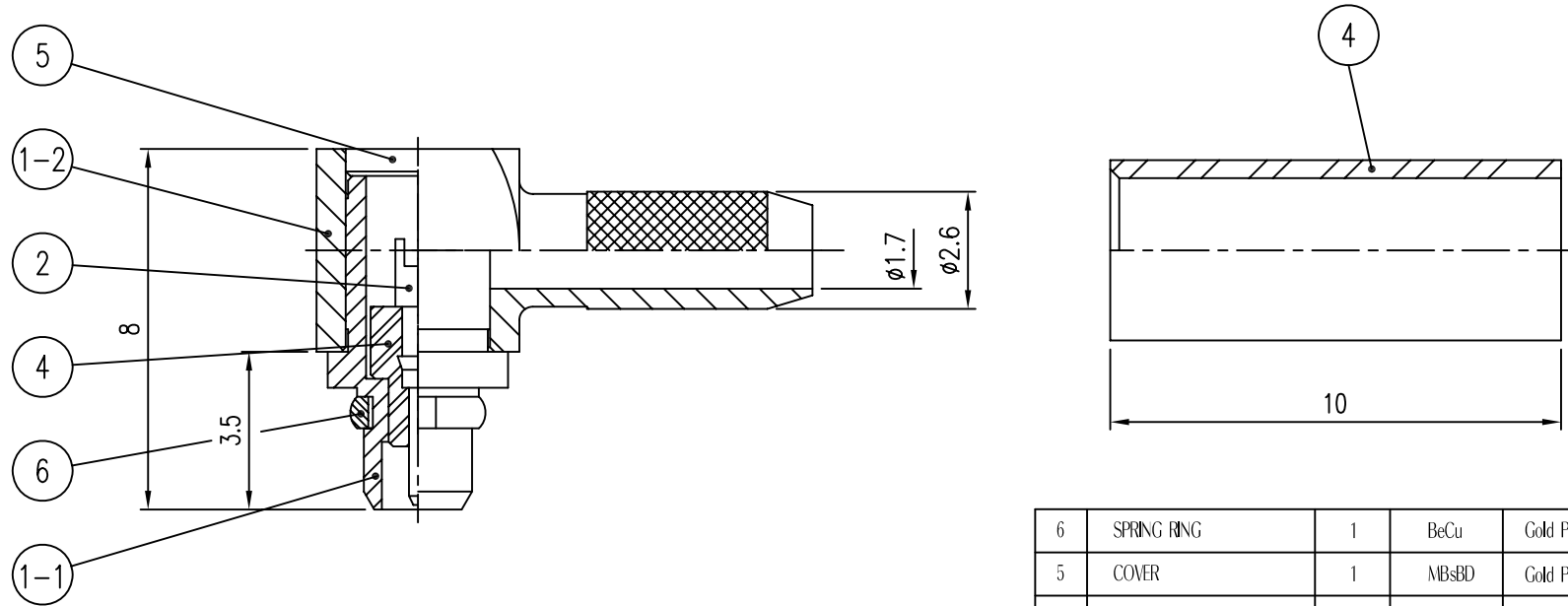


기재 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)											1	케넥터 암착부 보다 분리점 현상 방지로 인한 R추가 및 DBB코드 구성추가	은선영	김선호	2022. 01. 03.
ST(개선)											3	[실변No.202203-0008] 에다 공용화 부품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022. 03. 15.



6	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00001-1345/1 (R1501)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00007-15/1 (L1501)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00014-N/1 (H1501)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DFE00034-5/1 DFE00031-145/1 (F2002)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00014-135/1 (E1501)
1	1-2 BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00005-1/1 DBD00010-1/1
	1-1 BODY	1	MBsBD	Gold Plate	

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2001. 1. 26.					 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
재질	검도		도명 MMCX-LPC-316					
	재도							
열처리	작성부서					A4		
	연 구 소							
보호피막처리	적도 6/1		단위 mm	중량		도번 CN00012-7/1		
						K311-131-000		